

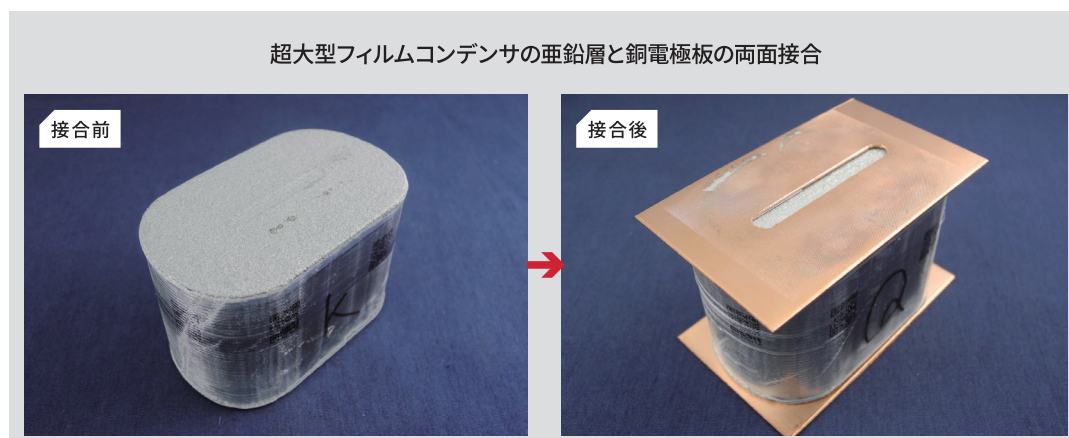
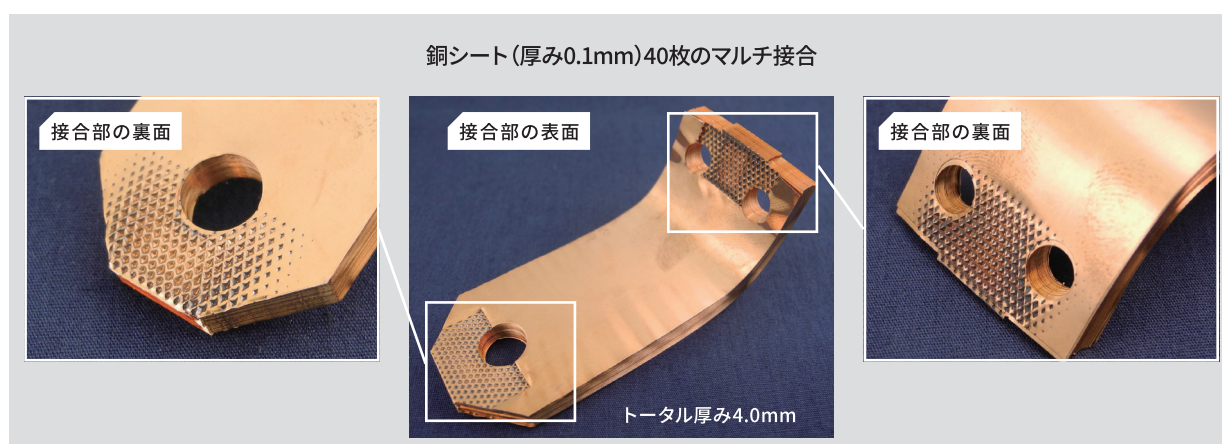


Application

Bonding ボンディング

大電力 積層タブと亜鉛電極の音波接合

高電圧・大電流の電力用 マルチ接合



Product used 使用する装置

15MZs



AP-J-0047A4-2019113001